



Laser marking



Laser marking and engraving system
Sistema di marcatura e incisione laser

Flexibility : Flessibilità

The knowledge of the process and of the application needs combined with the construction characteristics make BSP an innovative system for simplicity and productivity.

The range of **sources from 20 to 100W** allows you to perform engraving, marking, surface processing and micro-cutting processes aligned with the highest standards available.

La conoscenza del processo e delle necessità applicative abbinata alle caratteristiche costruttive fanno di BSP un sistema innovativo per semplicità e produttività. La gamma di **sorgenti da 20 a 100W** permette di eseguire processi di incisione, marcatura, lavorazioni superficiali e micro-taglio allineati con i più alti standard che lo stato dell'arte tecnologico permette.

Compact system : Sistema compatto

BSP has a compact and solid structure thanks to the granite working plane that guarantees **excellent process stability** for pieces up to 20 kg in weight. The base structure includes 3 motorized axes with 50 µm precision of movement, stroke on the plane of 300 x 300 mm and an amplitude along the Z axis of 300 mm. It can be equipped with a series of accessories like the rotating or rotary-tilting spindle, dynamic measuring and vision systems.

BSP presenta una struttura compatta e solida grazie al piano di lavoro in granito, che garantisce un'**ottima stabilità di processo** e una tenuta fino ai 20 kg di peso. La struttura base include 3 assi motorizzati con precisione di movimento di 50 µm, corsa sul piano di 300 x 300 mm e un'ampiezza lungo l'asse Z che raggiunge i 300 mm. Può essere equipaggiato con accessori come il mandrino rotante o roto-tiltante, il tastatore dinamico e i sistemi di visione.

Advanced software : Software avanzato

Entirely developed by SISMA, the integrated software is the ideal solution for managing files and the entire marking process, even in the case of complex jobs: allowing you to fully exploit all the potential of BSP PICO, it guarantees a **high degree of customization** to speed up and simplify the operator's work.

Interamente sviluppato da SISMA, il software integrato è la soluzione ideale per la gestione dei file e del processo di marcatura, anche nel caso di lavorazioni complesse: permettendo di sfruttare appieno le potenzialità di BSP, garantisce un **alto grado di personalizzazione** per velocizzare e semplificare il lavoro dell'operatore.



Technical Data - Dati tecnici

	200F EP	300F	500F	1000F
Active material - Materiale attivo	Yb	Yb	Yb	Yb
Average power - Potenza di uscita	20 W	30 W	50 W	100 W
Wave length - Lunghezza d'onda	1064 nm	1064 nm	1064 nm	1064 nm
Working frequency - Frequenza di lavoro	1 ÷ 1000 kHz	1 ÷ 500 kHz	1 ÷ 1000 kHz	1 ÷ 4000 kHz
Impulse duration - Durata impulso	3 - 500 ns	26 - 250 ns	6 - 500 ns	4 - 2000 ns
Peak power - Potenza di picco	> 10 kW	> 10 kW	> 10 kW	> 10 kW
Pulse energy - Energia di impulso	> 1 mJ	> 1 mJ	> 1 mJ	> 1,2 mJ
Beam quality - Qualità del fascio (M ²)	< 1,6	< 1,6	< 1,6	< 1,6
Cooling system - Raffreddamento	Air / aria	Air / aria	Air / aria	Air / aria
Axis stroke (XYZ) - Corsa assi (XYZ)	300 mm x 300 mm x 300 mm			
Max piece weight - Peso max pezzo	20 kg			
Precision - Precisione	0,05 mm			
Repeatability - Ripetibilità	0,02 mm			
Power supply - Alimentazione	230 V ± 15% 50/60 Hz - single phase - CEE 16A socket / presa			
Power absorption - Potenza assorbita	1 kW			
Dimensions (L x D x H) - Dimensioni (L x P x A)	823 mm x 1329 mm x h 1904 mm (h 2400 mm with open door - con porta aperta)			
Weight - Peso	590 kg			

The features, images, performances, weights and measures contained in the catalogue are completely indicative and approximate and may change without notice. Le caratteristiche, le immagini, le prestazioni, i pesi e le misure indicate si intendono del tutto indicativi ed approssimativi e possono variare senza preavviso.

10-2020